

成都市经济和信息化局  
中共成都市委组织部  
成都市财政局  
成都市投资促进局文件  
成都市教育局  
成都市地方金融监督管理局  
成都市国有资产监督管理委员会

成经信发〔2023〕4号

---

成都市经济和信息化局等7部门  
关于印发成都市加快集成电路产业高质量发展的  
若干政策的通知

各区（市）县政府（管委会），市级相关部门，有关单位：

经市政府同意，现将《成都市加快集成电路产业高质量发展

的若干政策》印发你们，请结合实际认真贯彻落实。

成都市经济和信息化局

中共成都市委组织部

成都市财政局

成都市投资促进局

成都市教育局

成都市地方金融监督管理局

成都市国有资产监督管理委员会

2023年2月16日

# 成都市加快集成电路产业高质量发展的 若干政策

为贯彻落实国家和四川省促进集成电路产业高质量发展的战略部署，抢抓集成电路产业重大发展机遇，加快优化产业体系，提升产业核心竞争力，聚力打造国家重要的集成电路产业基地，针对我市集成电路产业发展中的重点、痛点、难点，特制定本政策。

## 第一章 集成电路人才政策

**第一条 吸引人才来蓉发展。**鼓励集成电路领域高层次人才及优秀团队在蓉创新、创业、就业，对入选“蓉漂计划”、“蓉贝”软件人才的高层次人才给予最高不超过300万元、团队给予最高不超过500万元资助。对入选重大人才计划的专家人才，按照相关政策规定，在住房、创业、资金等方面给予政策支持。对企业人力资源成本支出超过30万元的集成电路企业高级管理人才和研发人才给予最高不超过50万元奖励。[责任单位：市经信局、市委组织部、有关区（市）县政府（管委会）]

**第二条 激励团队干事创业。**对年度主营业务收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元的集成电路设计企业，分别给予企业核心团队200万元、500万元、1000万元奖励；对年度主营业务收入首次突破10亿元、50亿元、100亿元的集成电路晶圆制造、封测企业，分别给予企业核心团队200万元、500万元、1000万元奖励；对年度主营业务收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元的集成电路装备、材料企业，分别给予企业核心团队200万元、

500 万元、1000 万元奖励。对芯片产品入选“中国芯”优秀产品名单的企业，按每个产品 50 万元给予产品研发团队奖励。（责任单位：市经信局）

**第三条 加强人才培养能力。**鼓励高校和职业（技工）院校围绕集成电路产业发展需要调整学科（专业）设置，给予最高不超过 2000 万元支持。支持高校开展示范性微电子学院和“集成电路科学与工程”一流学科建设，推动增加集成电路相关专业本科生、研究生招生名额，对新获批示范性微电子学院或一流学科的高校给予 500 万元支持。鼓励集成电路企业或行业组织与高校开展产教融合，给予每家企业或行业组织最高不超过 100 万元补助。（责任单位：市教育局、市经信局）

## **第二章 集成电路设计业政策**

**第四条 推动设计能力提升。**对从事集成电路 IP 核和 EDA 工具研发的企业，按研发费用 20% 给予最高不超过 500 万元补助。对购买 IP 核、EDA 工具、测试设备用于芯片研发的集成电路设计企业，按购买费用 50% 给予最高不超过 200 万元补助。对完成全掩膜首轮工程产品流片的集成电路设计企业，按重点支持方向流片费用 50%、非重点支持方向流片费用 30% 给予单个企业年度总额最高不超过 1000 万元补助。对使用多项目晶圆流片进行研发的企业或高校科研院所，给予流片直接费用 50%、年度总额最高不超过 100 万元补助。（责任单位：市经信局）

## **第三章 集成电路制造业政策**

**第五条 加强重大项目招引。**对总投资 5 亿元（含）以上的

集成电路制造、封测、装备、材料类的重大项目，根据其技术产品、工艺水平和市场前景等，按固定资产投资额 10% 给予企业最高不超过 5 亿元综合支持。对特别重大的项目，按“一事一议”原则，在研发、固投、融资、载体、能源等要素保障方面依法依规给予支持。[责任单位：有关区（市）县政府（管委会）、市经信局、市投促局、市财政局]

**第六条 提升产业协同水平。**强化产业链上下游协同，鼓励晶圆制造产线为设计企业提供代工流片服务，按每片晶圆（硅基集成电路折合 8 英寸，化合物集成电路折合 6 英寸）100 元的标准，给予年度总额最高不超过 1000 万元支持。鼓励封装测试产线为设计企业提供封装测试服务，按封测费用的 5% 给予年度总额最高不超过 200 万元支持。（责任单位：市经信局）

#### **第四章 完善产业生态环境政策**

**第七条 提升产业服务能力。**支持集成电路公共服务平台能力提升，按平台上一年度新增投资的 20% 给予最高不超过 200 万元补助。鼓励集成电路公共服务平台为企业 provide EDA 工具共享、IP 复用、快速封装测试、失效分析、流片代理等服务，按照服务费用的 20% 给予最高不超过 100 万元补助。支持集成电路行业组织举办项目路演、技术论坛、专业会展、创新创业大赛等活动，为企业搭建要素对接平台，经评估，给予最高不超过 200 万元补助。（责任单位：市经信局）

**第八条 鼓励实施“投补结合”。**推动国家、省、市、区投资机构、行业组织以及集成电路骨干企业，共同组建成都市集成电

路产业投资基金，鼓励市属国有企业加大对集成电路重点企业和重大项目的投资力度。对享受政策补贴的集成电路企业或项目，鼓励市区两级国有投资平台以跟投模式进行市场化股权投资支持，原则上单次跟投金额不超过 1 亿元，且不超过企业单轮融资额的 30%。[责任单位：市国资委、市经信局、市金融监管局、有关区（市）县政府（管委会）、成都产业集团]

## 第五章 附 则

**第九条 适用范围。**本政策适用于具有独立法人资格的从事集成电路产业相关服务的企事业单位及机构（行业协会、民非组织），以及符合条件的高校、科研院所及有关人才。

**第十条 支持重点。**本政策重点支持集成电路线宽小于 28 纳米（含）的 12 英寸先进生产线，以及化合物半导体、数模混合电路、IGBT 等特色工艺生产线建设项目，信息通信、通用计算、高端存储、智能感知等领域芯片设计开发项目，芯片级、晶圆级、系统级、三维封装等先进封装测试产业化项目，以及配套关键设备和材料产业化项目。

**第十一条 政策解释。**本政策由市经信局会同市级有关部门负责解释。本政策与市级其他支持政策交叉重叠的，按就高原则执行，不重复支持。国家和省上政策另有规定的从其规定。在国家、省、市相关政策有重大调整时，根据实际情况调整本政策。各区（市）县相关部门应当严格执行市级财政专项资金和政策性项目管理的有关规定，加强资金监管，规范资金使用，做好绩效考评，提高资金使用效率，可参照本政策制定适合本区域集成电

路产业高质量发展的政策。

**第十二条 有效期限。**本政策自印发之日起 30 日后施行，有效期 3 年，市经信局、市财政局印发的《成都市支持集成电路产业高质量发展的若干政策》（成经信发〔2020〕5 号）同时废止。

**信息公开属性：主动公开**

---

成都市经济和信息化局办公室

2023年2月16日印发

---